

## PlasmaTEC-X OEM 常压等离子表面处理设备

新型设计 技术革新

### 产品特征:

- 安装简便
- 零电势的等离子工艺
- 速度快
- 数字/模拟控制信号
- 自动调整气流
- 待机节能气流控制
- 体积小, 重量轻
- 输出放电控制



Tantec的PlasmaTEC-X是根据常压下高压直流等离子放电原理而设计的新型表面处理设备。该设备既可以单独集成到机器人系统中,也可以集成到任一生产线上。

喷枪中的等离子需要在一定的气压下放电,释放出足够的能量,处理产品表面。无论管路有多长,PlasmaTEC-X主机都可以自动调机喷枪中的气流,因为内置的AirTEC系统可以为其源源不断的提供稳定气流。

AirTEC系统和统一的电源输入让PlasmaTEC-X使用更加简单方便。无需任何调整,只需要连接电源和压缩空气即可使用。

该设备先进的设计是“待用空气量低”。通过HMI,操作员可以在待机状态下设定气流量,避免放电电极头吸附到灰尘。

PlasmaTEC-X主机的所有连接喷嘴的接口都是标准插口,因此使用就变得更加简单方便。基于直流电放电技术和AirTEC的设计,不论连接线缆有多长,都无需进行任何调整。

#### Head Office

Tantec A/S  
Industrivej 6  
DK-6640 Lunderskov  
(+45) 7558 5822

Mail:  
sales@tantec.com

Web:  
www.tantec.com  
www.china-tantec.com (中文)

中国区总代:  
昆山市坦钛等离子科技有限公司

Tel:  
0512-50333890

Mobile:  
13862667395

Mail:  
sales@china-tantec.com

## 特点:

- 安装简便 仅需连接电源和压缩空气，无需调节气压和电源。
- 零电势的等离子工艺 可处理导体、非导体和半导体产品表面。
- 速度快 等离子放电能量高，可适应高速生产线。
- 控制信号 在数字界面会显示各种不同的信号，实时控制和监控等离子放电。
- 自动调整气流 不论电源线或喉管的长度多长，主机都会自动调整，以保证提供适量的气压和气体流量。
- 待用气流 待用气流方式通过操作屏可以打开或关闭，同时避免了气源的浪费和灰尘对喷枪的影响。
- 体积小，重量轻 该特性使得PlasmaTEC-X可以很轻松地集成到几乎任一生产线上或机器人系统中。
- 输出放电控制 若输出电压低于预设值，主机会发出警报信号。

技术参数	PlasmaTEC-X 主机	PlasmaTEC-X 喷嘴
电源电压和频率	100-250VAC – 50/60Hz (统一的电源输入)	N/A
输出电压/功率	550VA	425watt
启动时间	10 ms	N/A
关机时间	< 1 ms	N/A
控制接口	M12 (8 线)	N/A
规格 (宽x长x高)mm	150x470x198	OD30x206mm
重量 ( kg )	6,1	1,1 (包括2m的喉管)
处理宽度 mm	N/A	8-14mm
压缩气体	5-6 bar, 干燥清洁	N/A
压缩气体接口	OD8mm 快速连接	N/A
气体消耗量	N/A	33 ltr/min
每个 PlasmaREMOTE 可连接的数量	N/A	N/A
遵循法规	CE- RoHS - WEEE	CE- RoHS - WEEE